

MEMORIAL DESCRITIVO DISCO DGP8761

1. INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Função: Realizar o afinamento de Wafers de $\Phi 300\text{mm}$ de diâmetro através do processo de abrasão com rebolos diamantados visando possibilitar o empilhamento de chips de memória dentro da estrutura do produto.

Modelo: DGP8761

Fabricante: DISCO Corporation

2. FOTO DO EQUIPAMENTO



DFM2800

DGP8761

3. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

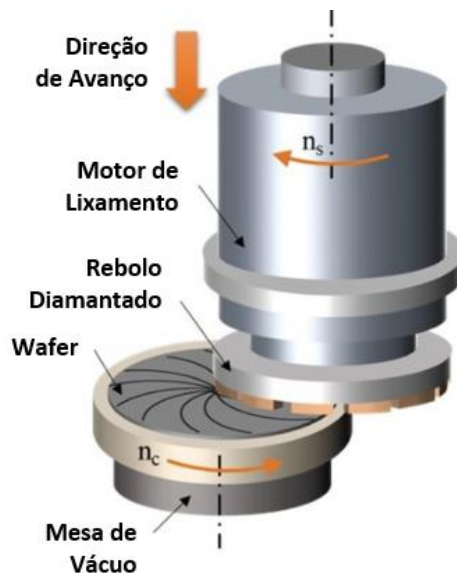
O DGP8761 integra afinação de wafers com processamento de alívio de estresse mecânico, realizando retificação fina e estável em espessuras inferiores a 25 μm . A DGP8761 é equipada com um eixo desenvolvido para suportar lixamento de alta velocidade. Isso contribui para um tempo de processamento de wafers finos mais curto. Além disso, um layout de manuseio otimizado reduz o tempo do ciclo (sem incluir o tempo de processamento).

Ao integrar o DGP8761 com um montador de wafers, a DFM2800, é possível suportar a fixação do wafer em frames com fita de corte e de DAF (Fita de anexação de unidades) para wafers finos.

Para isso o equipamento de afinamento de wafers DGP8761 conta com um sistema de lixamento de wafers capaz de atingir espessuras de 25 microns e polimento com alta qualidade de rugosidade superficial com baixa pressão aplicada sobre o wafer afim evitar rompimento do circuito integrado impresso no wafer.



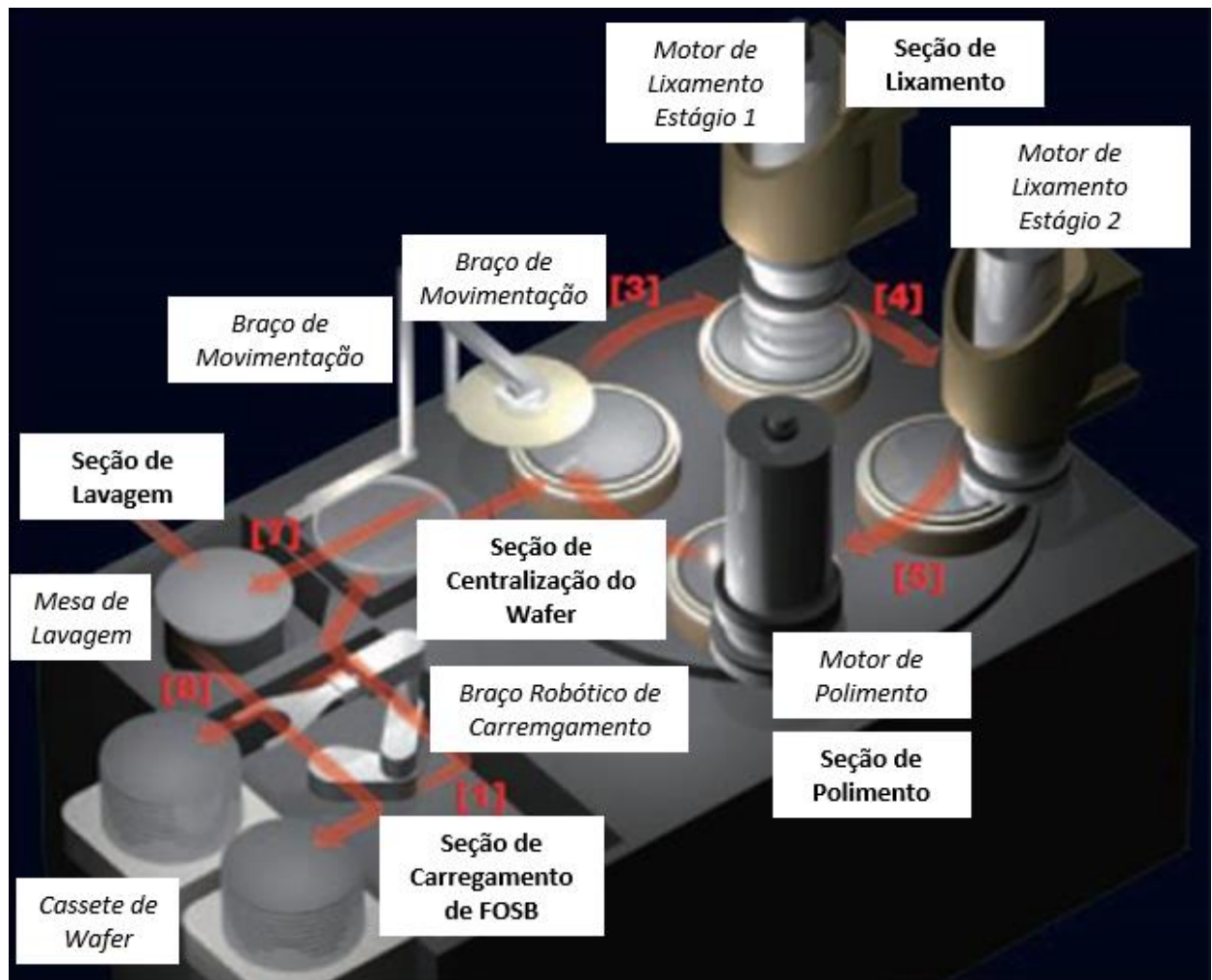
DGP8761



**Imagem meramente ilustrativa*

Para evitar qualquer perigo para os operadores, intertravamentos de hardware são instalados em locais inerentemente perigosos, impossibilitando a abertura do equipamento durante processamento.

Seguem abaixo as seções e sistemas embarcados no equipamento:



1. O robô remove os wafers do cassete e o coloca na mesa de posicionamento, onde ocorre a centralização;
2. O braço T1 posiciona o wafer na mesa de lixamento;
3. O wafer segue para Z1 para desbaste grosseiro;
4. O wafer segue para Z2 para desbaste fino;
5. O wafer segue para Z3 para polimento a seco;
6. O braço T2 remove o wafer da mesa de lixamento e o coloca na mesa de limpeza e secagem;
7. Unidade de limpeza e secagem;
8. Área de transferência para o montador (DFM2800) ou o robô retorna o wafer para o cassete.

4. ESPECIFICAÇÕES

Especificação	Unidade	Dado
Tamanho de peça suportado	mm	Φ200 / Φ300
Método de lixamento (eixos Z1 / Z2)	-	Avanço de lixamento com rotação do wafer
Método de lixamento (eixo Z3)	-	Avanço de lixamento com rotação do wafer invertida
Rebolo de lixamento	-	Φ300 mm rebolo diamantado (Eixos Z1 / Z2) Φ450 mm lixamento a seco (eixo Z3)
Dimensões do equipamento (L×P×A)	mm	1690 x 3452 x 1800
Peso do equipamento	kg	Apox. 6700